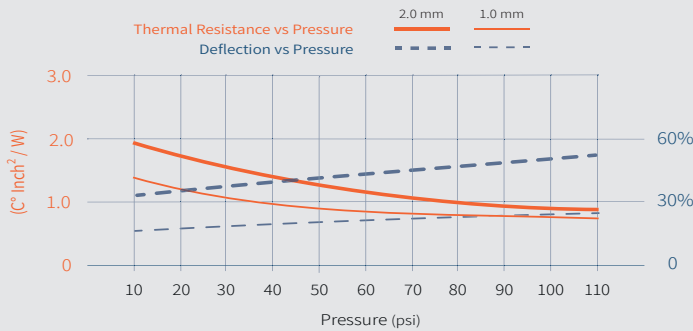


Thermal Interface Material Silicone Gap Filler



Verstärkung
Reinforced layer
V = mit / with

Materialstärke
Material thickness
1.00 = 1.00 mm

DS-GAP-SGS35-1.1-**X.XX**-**X**

DS-GAP-SGS35-1.1

Wärmeleitfähigkeit¹ Thermal Conductivity ¹	W/mK	1.10
Härte² Hardness ²	Shore 00	35
Einsatztemperatur Operation Temperature	°C	-50 / +200
Materialstärke Material Thickness	mm	0.50 - 7.00
Durchschlagsfestigkeit³ Dielectric Strength ³	kV/mm	5.00
Verstärkung Reinforced Layer	√	optional
Konformität Conformity	√	RoHS
Dichte Density	g/cm ³	1.80

¹ ASTM D5470 ² ASTM D2240 ³ ASTM D149

REV2017_01

Technische Änderungen vorbehalten, alle technischen Daten und Angaben unverbindlich.
Subject to technical alterations, all technical data and details are not binding.